

# 昇陽半導體2025年第4季法說會

---

March 2026

# 免責宣言

- 昇陽半導體對其目前期望的陳述是前瞻性陳述，受到重大風險和不確定性的影響，實際結果可能與前瞻性陳述中包含的內容有重大差異。
- 有關可能導致實際結果變化的因素的資訊，可在昇陽半導體向台灣證券交易所公司（TWSE）提交的年度或季度報告以及PSI不時向TWSE提交的其他文件中找到。
- 除非法律有要求，否則我們不承擔更新任何前瞻性陳述的義務，無論是因為新資訊、未來事件或其他原因。
- 此份報告的數字是按照國際財務報導準則（IFRS）編制的。

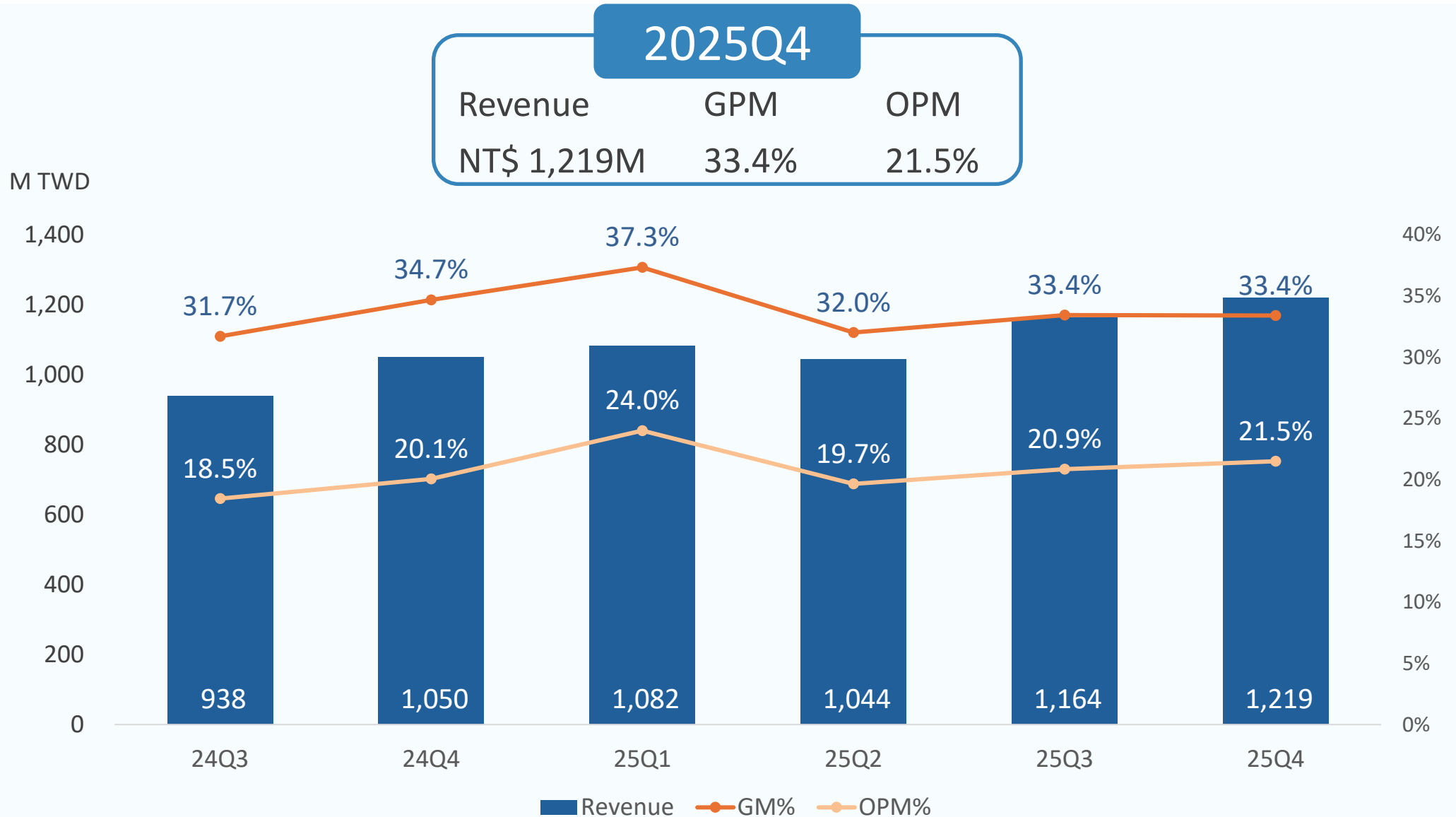
# Agenda

- 25Q4財務表現
- 半導體產業展望
- 成長動能
- 護城河
- 核心訊息

# 25Q4財務表現

---

# 財務表現



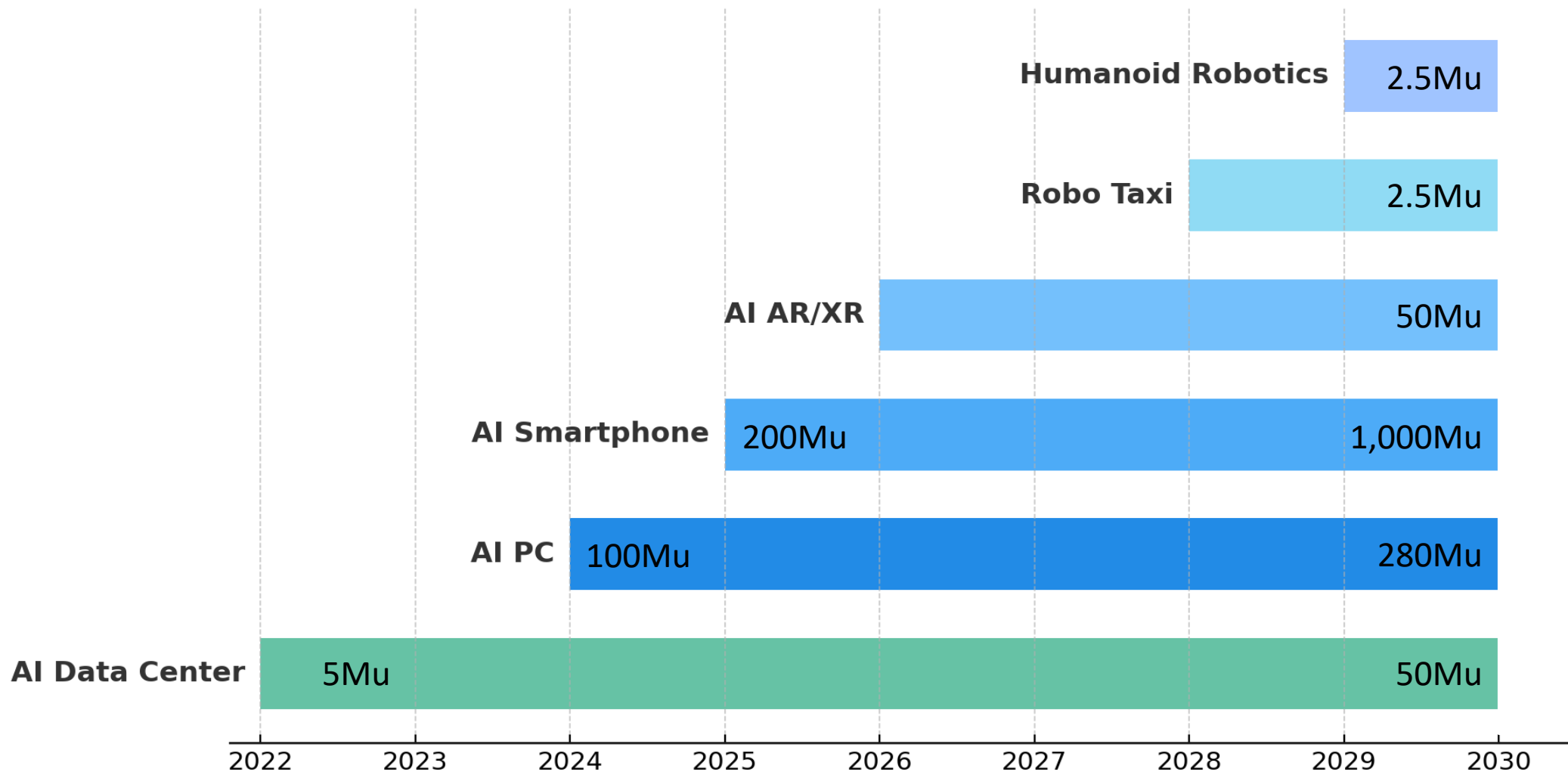
# 財務指標

Item	2024Q4	2025Q3	2025Q4	Y2024	Y2025
晶圓出貨量 (千片十二吋約當晶圓)	1,963	2,531	<b>2,599</b>	6,869	9,486
營業收入淨額 (美元百萬元)	32	38	<b>39</b>	110	144
營業收入淨額 (新台幣百萬元)	1,050	1,164	<b>1,219</b>	3,551	4,509
營業毛利率	34.7%	33.4%	<b>33.4%</b>	28.8%	34.0%
營業淨利率	20.1%	20.9%	<b>21.5%</b>	15.1%	21.5%
純益率	19.0%	17.3%	<b>18.4%</b>	15.7%	16.8%
每股盈餘 - (新台幣元)	1.16	1.17	<b>1.29</b>	2.85	4.37
股東權益報酬率 (年化)	19.9%	17.8%	<b>18.3%</b>	12.2%	16.4%
營業現金流 (新台幣百萬元)	449	261	<b>410</b>	1,491	1,401
資本支出 (新台幣百萬元)	549	-313	<b>-1,135</b>	-1,364	-3,180
自由現金流量 (新台幣百萬元)	-100	-52	<b>-723</b>	126	-1,779

# 半導體展望

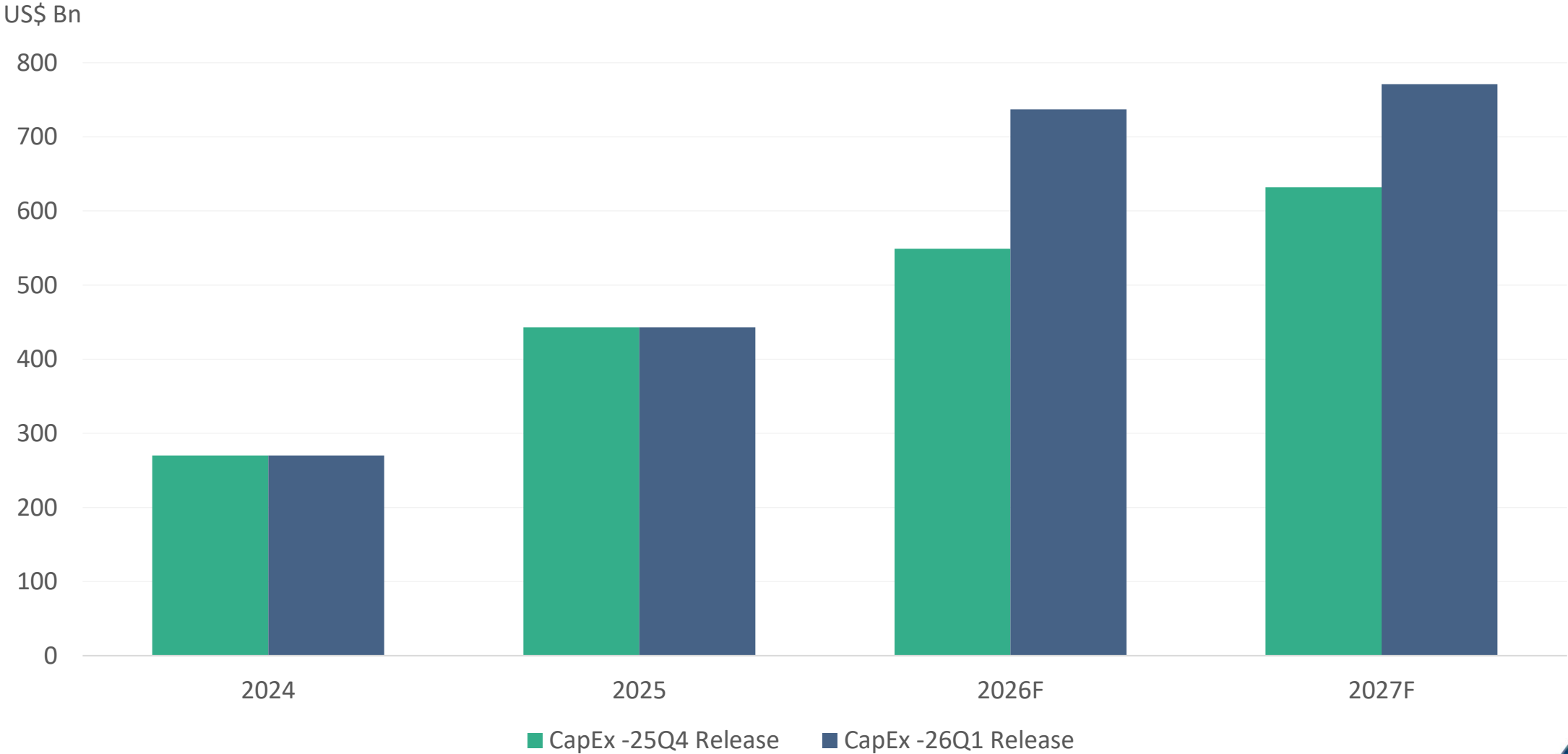
---

# AI 推動半導體市場邁向 1 兆美元



Source: WSTS, IDC, TSMC

# 主要CSP商 加大資本支出



Source: UBS, GS

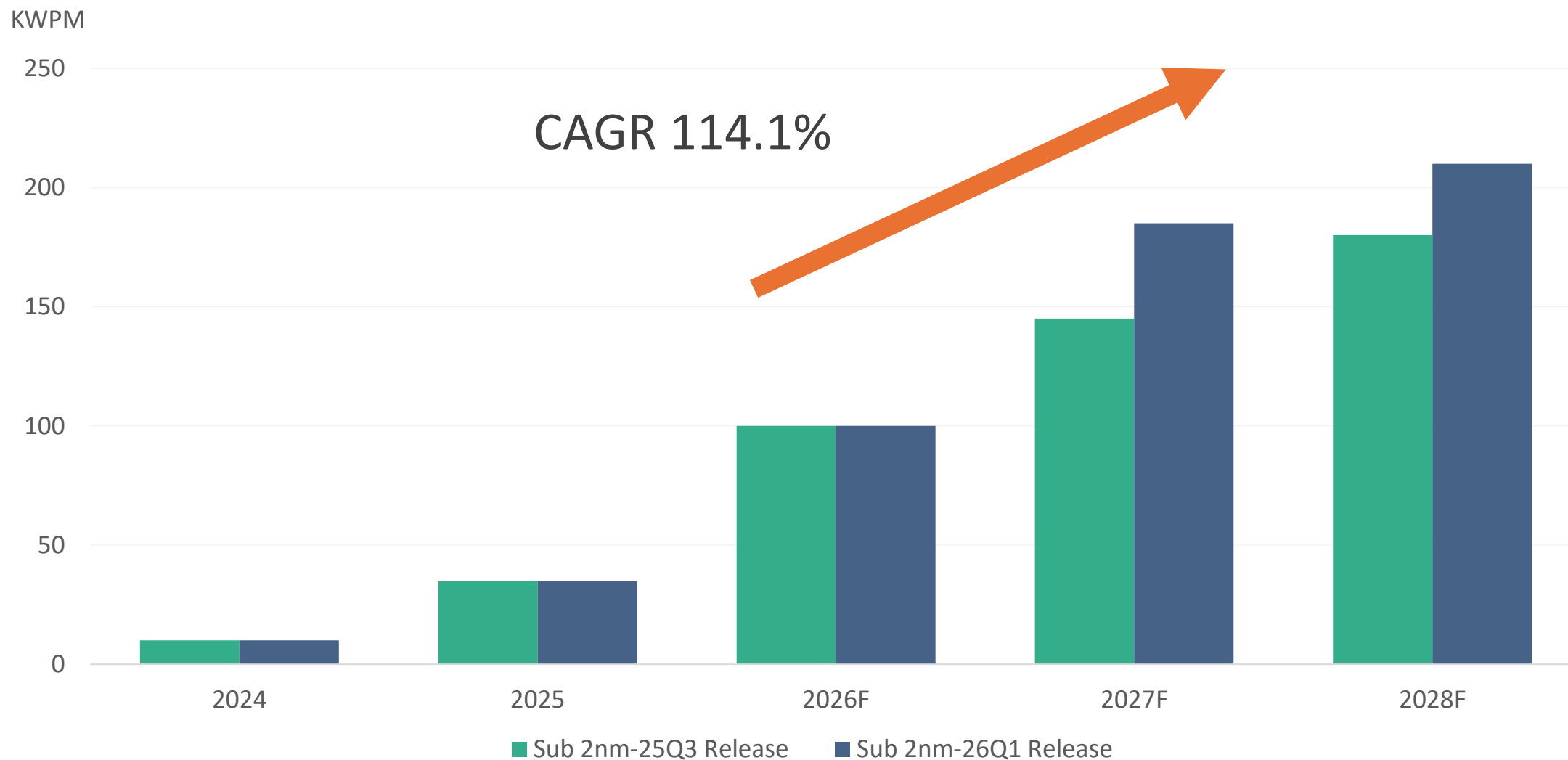


# 成長動能

---

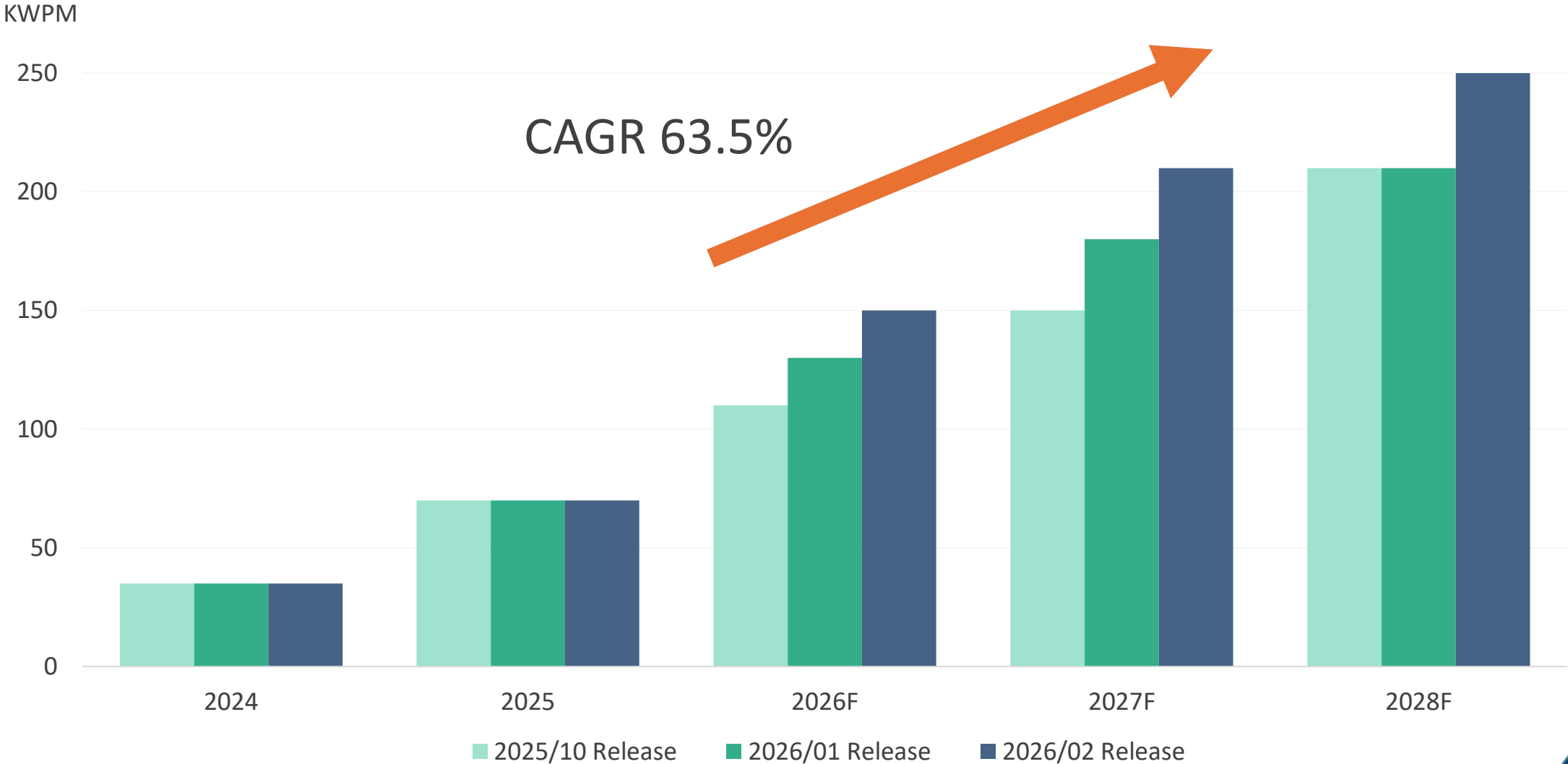
再生晶圓：先進技術、高效率、規模化成長

# Sub 2nm 產能快速擴張



Source: JPM, UBS ,GS

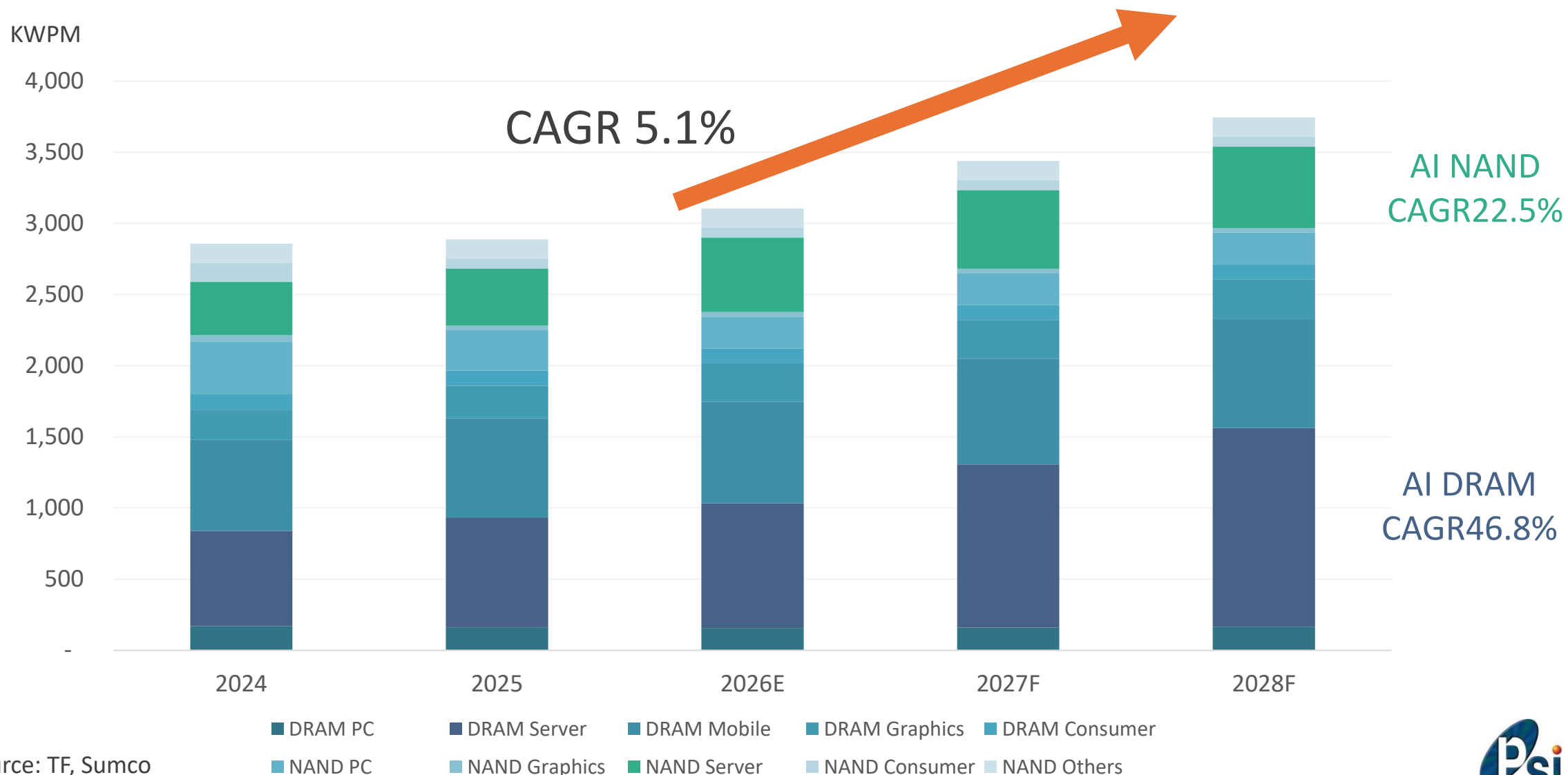
# 先進封裝產能迅速增加



Source: JPM, UBS ,GS



# 記憶體投片量提升



Source: TF, Sumco



# 製程日益複雜 帶動再生需求成長

- 結構轉變與設計挑戰
- 製程精準度與良率挑戰

FinFET



Nanosheet

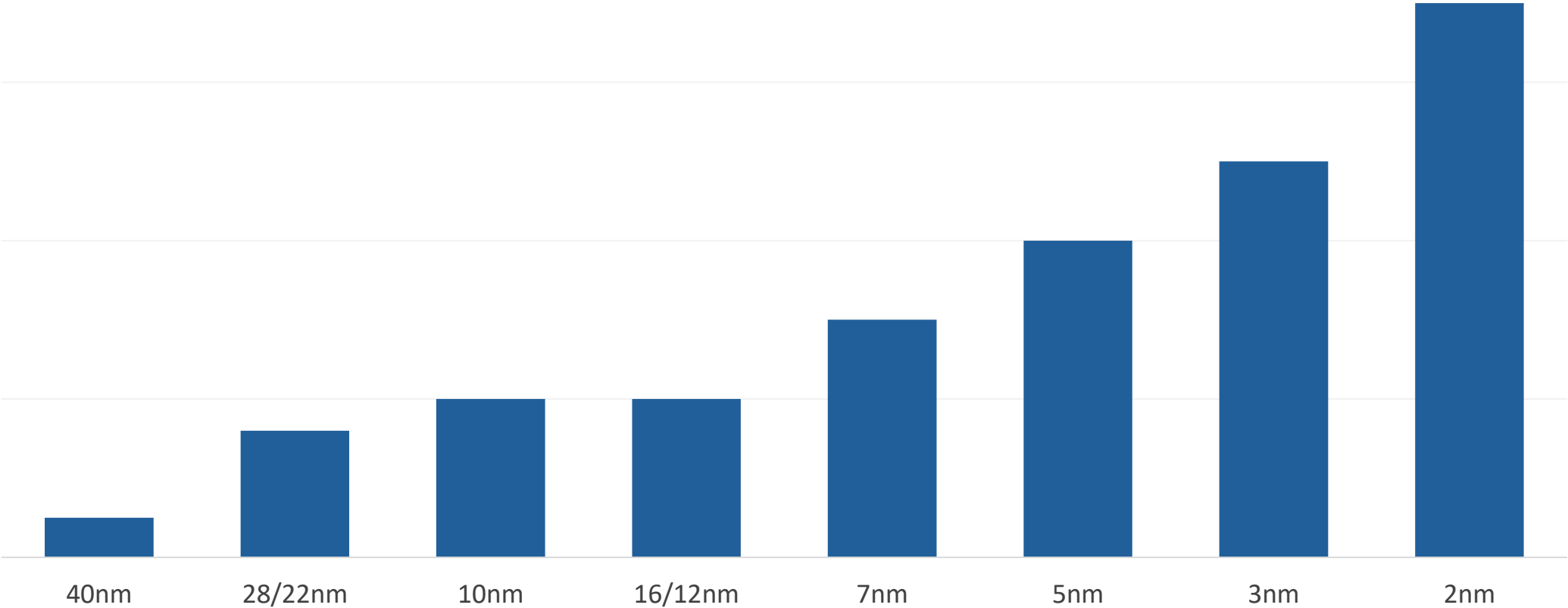


Forksheets



# 再生晶圓使用比率大幅提升

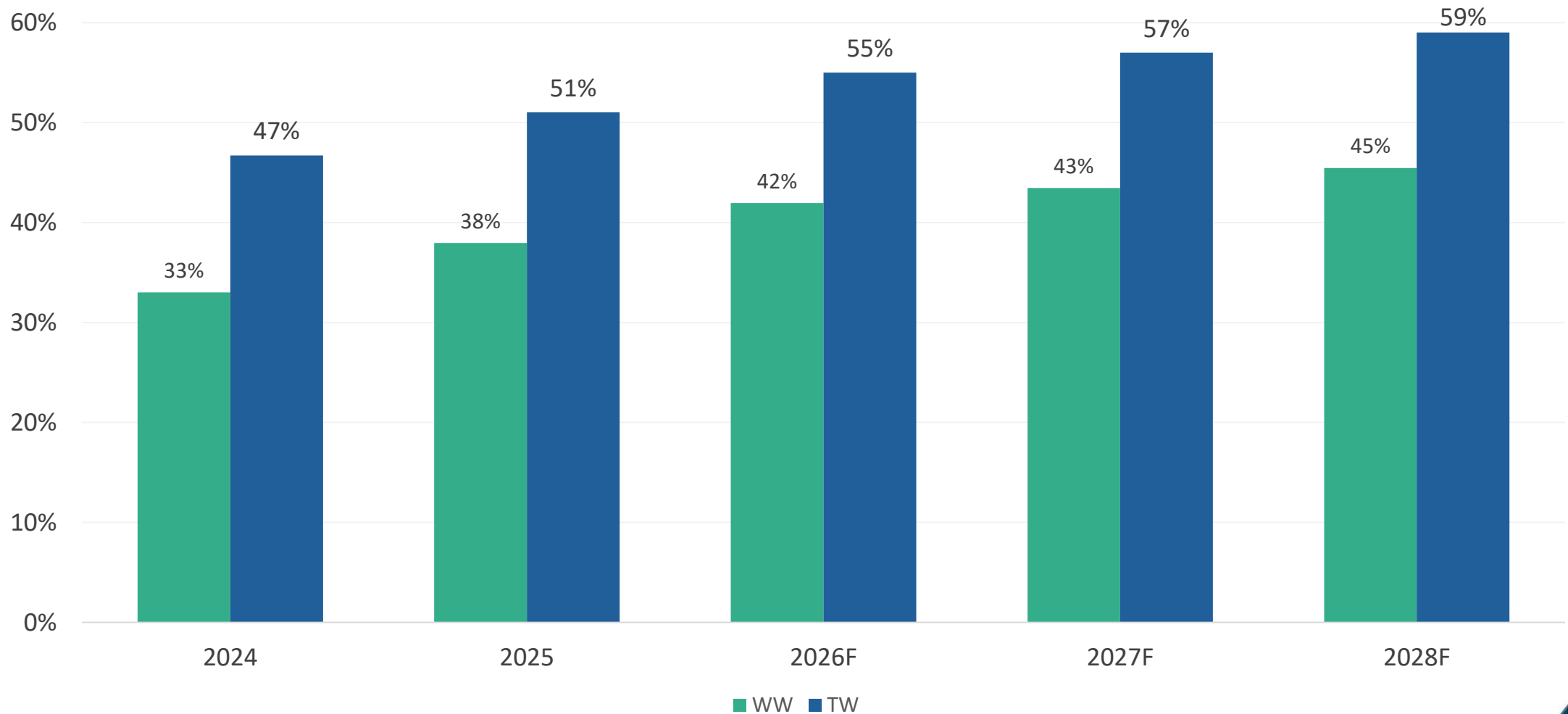
Reclaim Usage Ratio



Source: PSI estimate



# 快速擴大市佔率



Source: company data, PSI

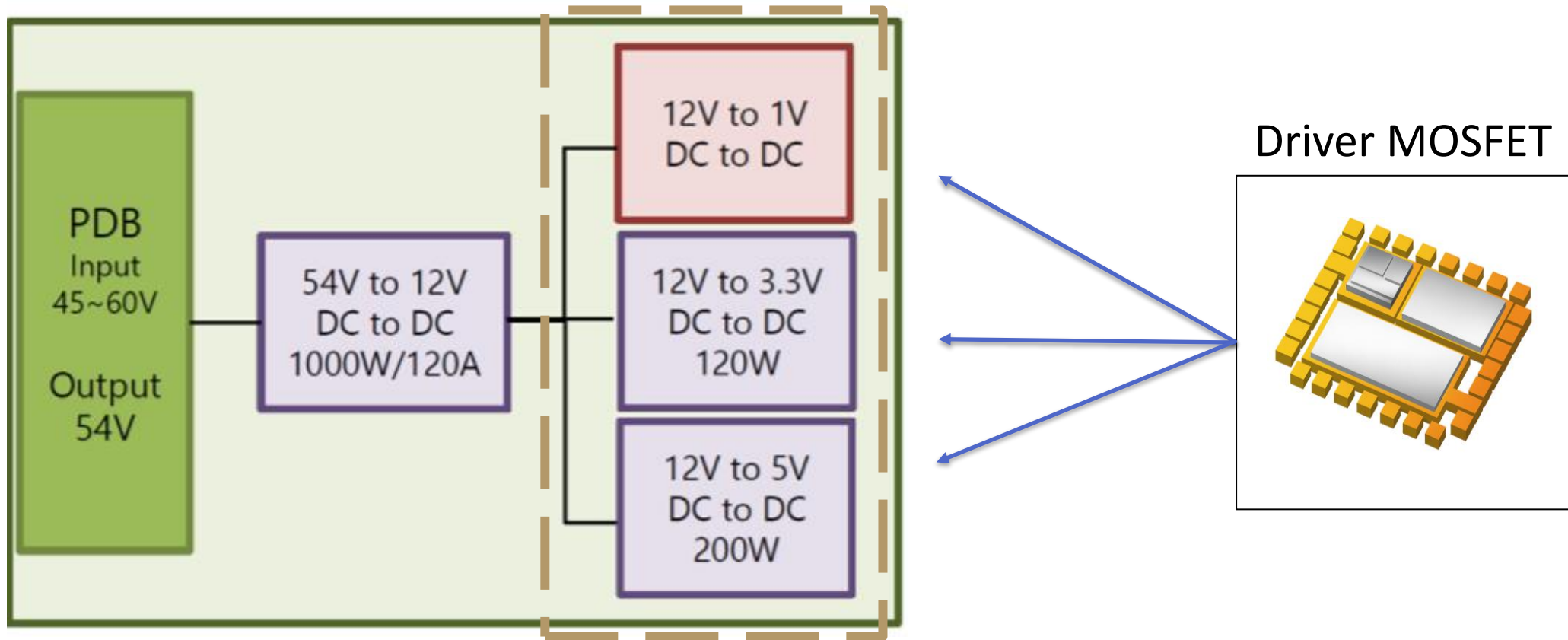


# 成長動能

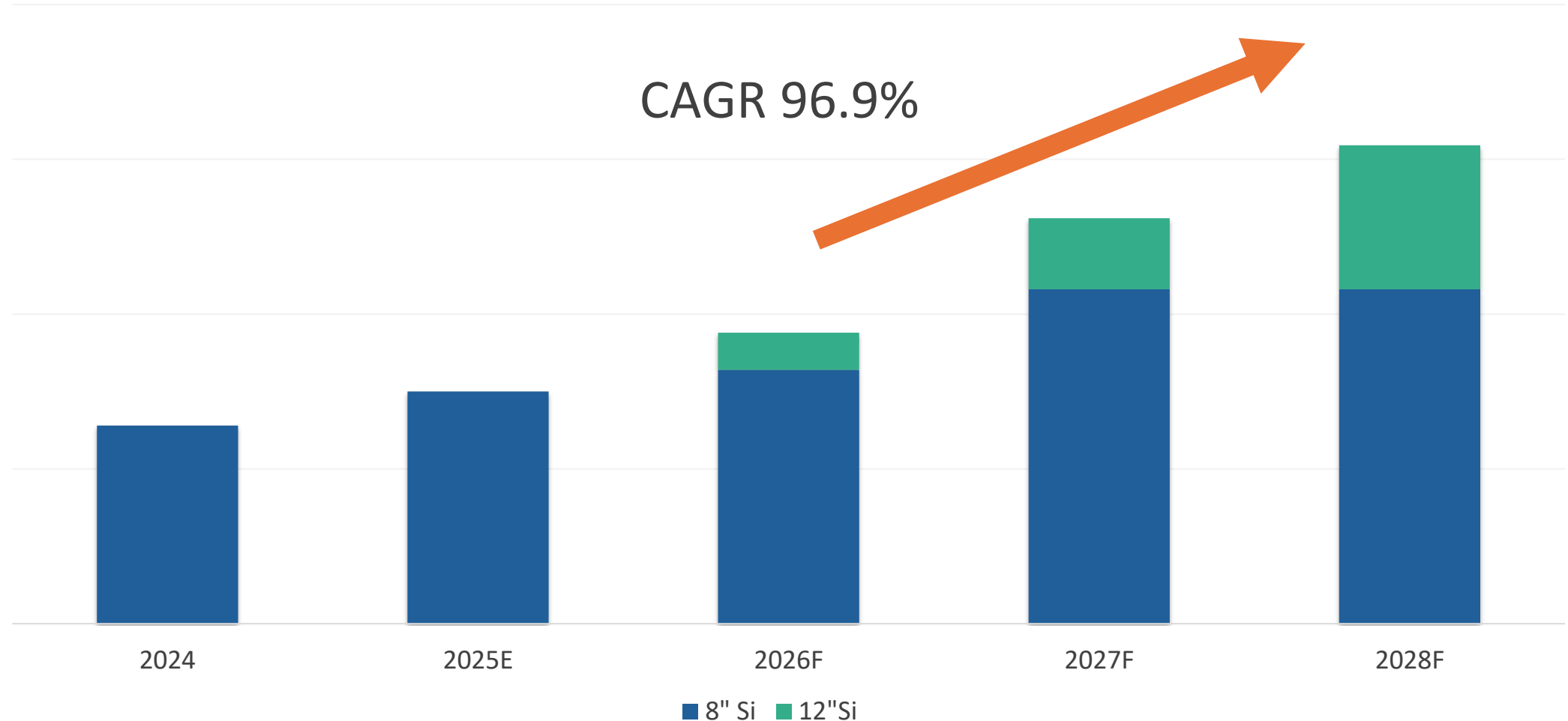
---

薄化成長亮點：12 吋矽與碳化矽應用

# AI 引領 Dr. MOS 新的成長動能



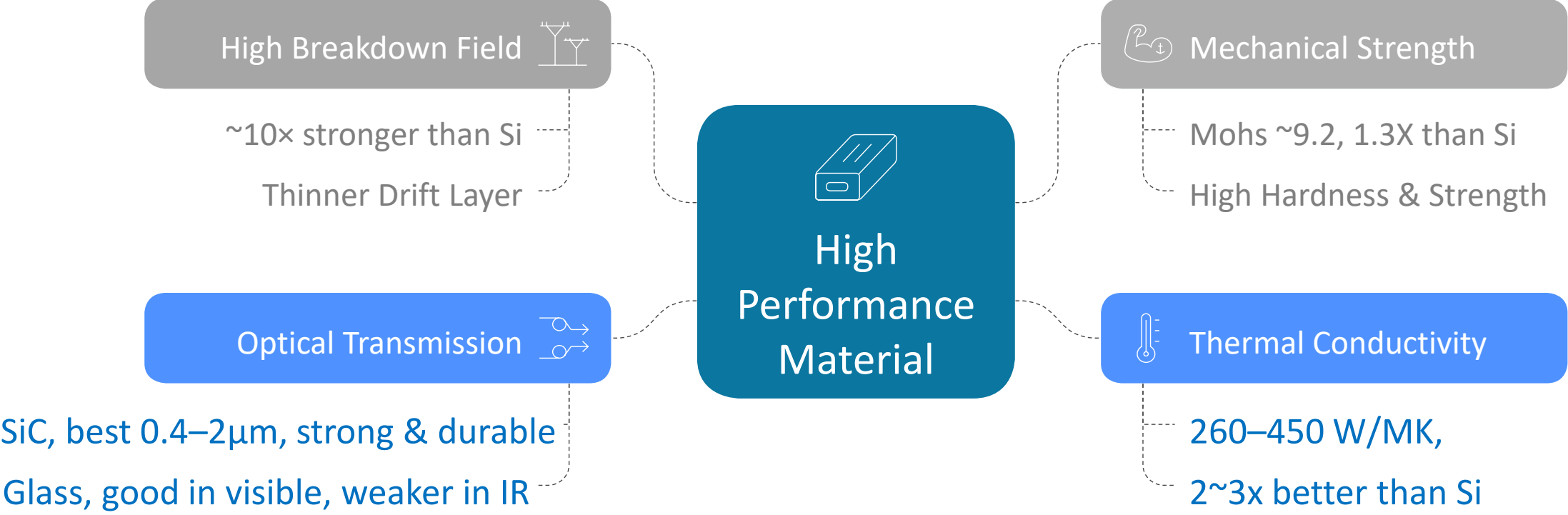
# 擴展 12 吋薄化能力 因應次世代需求



Source: PSI estimate



# 超越矽材料 – 碳化矽的關鍵特性

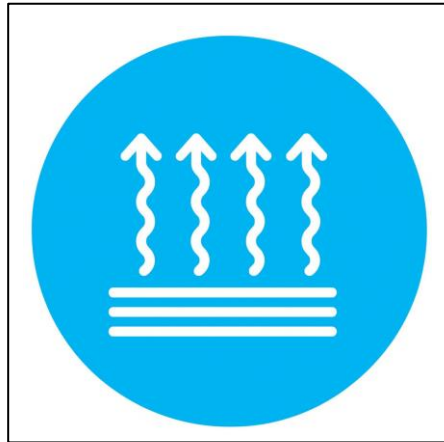


Source: company data, PSI

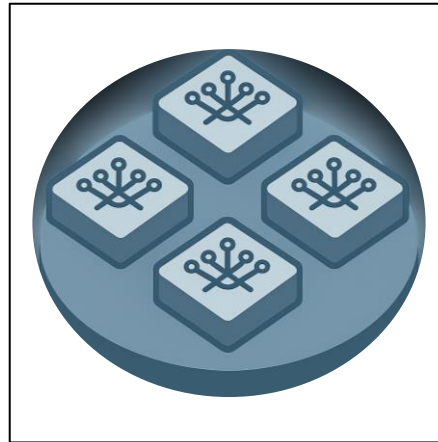


# 碳化矽新時代

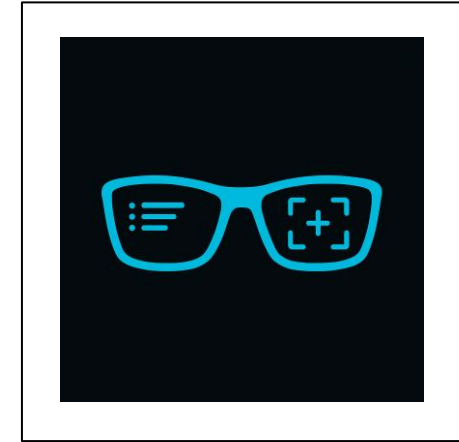
Heat Dissipater



IC Substrate



Specialty glass



# 護城河

---

# 昇陽半導體護城河

## 科技

- 支援自動化搬運之「Dry in Dry out」研磨技術
- 品質趨近正式片 (Near-prime) 等級



## 效率

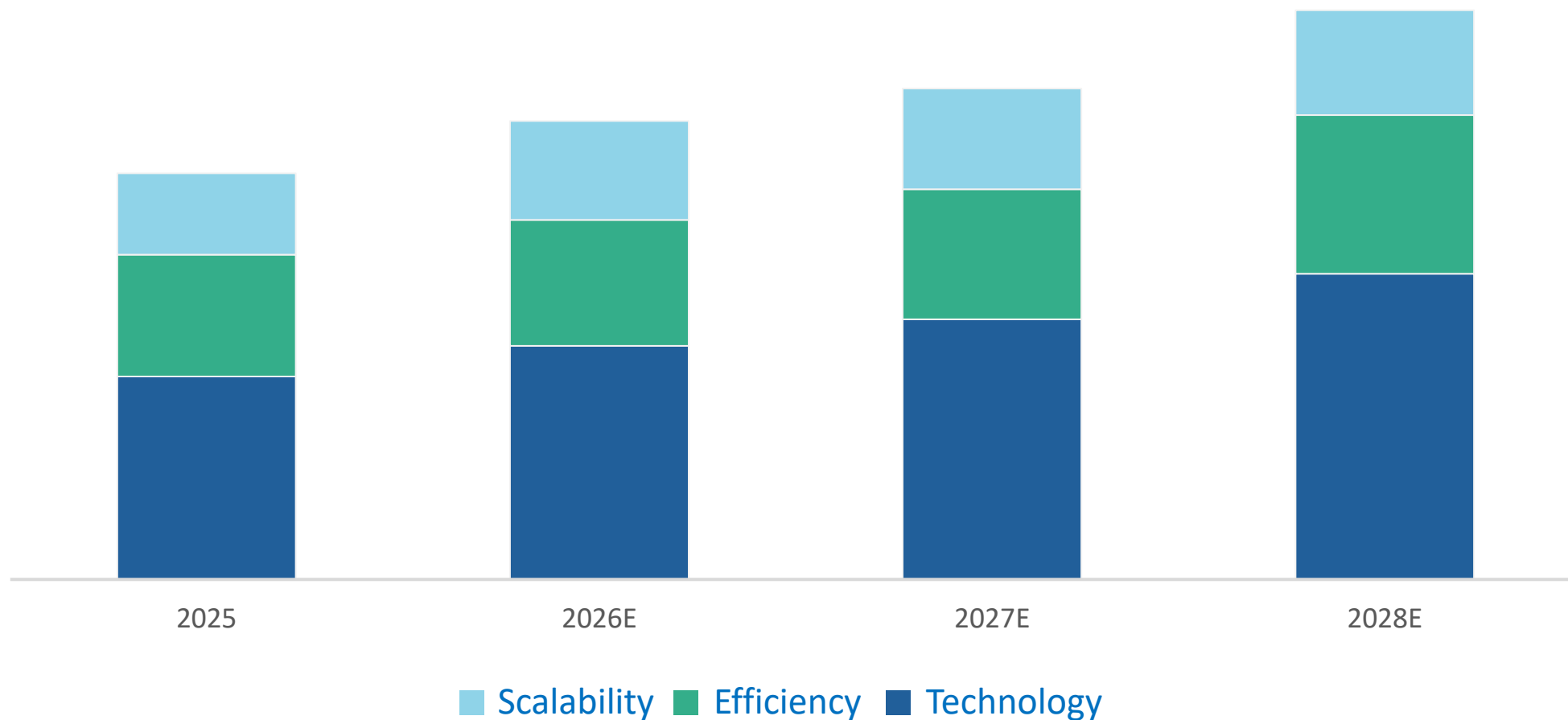
- 透過自動化與 AI 優化流程
- 3年內 人均產值翻倍

## 規模

- 規模領先：佈建全球首屈一指產能
- 客戶穩固：深耕一線大廠合作夥伴

# S.E.T.啟動成長新動能

將規模化、效率與技術優勢，轉化為長期永續獲利



# 核心訊息

---

# 核心訊息

- PSI 的企業護城河：技術、效率與規模化能力
- 乘著 AI 浪潮：先進製程與先進封裝帶來的關鍵需求
- 卓越營運：透過 AI 自動化驅動獲利能力提升
- 開啟第二成長曲線：12”碳化矽 (SiC) 晶圓加工技術
- 策略性擴張：佈建未來十年的產能需求

<https://www.psi.com.tw>

[ir@psi.com.tw](mailto:ir@psi.com.tw)

---